【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年7月25日(2013.7.25)

【公開番号】特開2012-156484(P2012-156484A)
【公開日】平成24年8月16日(2012.8.16)
【年通号数】公開・登録公報2012-032
【出願番号】特願2011-223050(P2011-223050)
【国際特許分類】
*Ｈ０１Ｌ　33/64　(2010.01)*
*Ｈ０１Ｌ　33/60　(2010.01)*
*Ｈ０１Ｌ　33/62　(2010.01)*
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　33/00　４５０
Ｈ０１Ｌ　33/00　４３２
Ｈ０１Ｌ　33/00　４４０

【手続補正書】
【提出日】平成25年6月10日(2013.6.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
支持基板と、発光素子とを含む発光デバイスであって、
前記支持基板は、２つの貫通電極と、複数の柱状ヒートシンクとを含み、一面に発光素子配置領域を有しており、
前記貫通電極のそれぞれは、前記支持基板を厚み方向に貫通し、一端が前記発光素子配置領域の面内に露出しており、
前記発光素子は、Ｐ型半導体層及びＮ型半導体層を積層した構造を含み、前記支持基板の前記凹部内に配置され、前記Ｐ型半導体層のＰ側電極が、前記貫通電極の一方の前記一端に接続され、前記Ｎ型半導体層のＮ側電極が、前記貫通電極の他方の前記一端に接続されており、
前記柱状ヒートシンクは、前記支持基板の厚み方向に設けられ、前記発光素子配置領域を取り囲んで、その周りに互いに間隔をおいて配置され、それぞれの一端が、前記支持基板の他面に付着して一体に設けられた放熱体に共通に接続されており、
前記支持基板は、Ｓｉを主成分とする基板である、
発光デバイス。